

JEITA

電子情報技術産業協会規格

Standard of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

JEITA ET - 7501/105

表面実装用部品のランドパターン設計指針：

個別規格 品種別要求事項

(4方向Jリード)

Land pattern design guideline for surface mount devices (SMD

Sectional requirements

(Chip carriers with J-Leads on four sides)

2006年9月制定

作成

実装技術標準化委員会

Technical Standardization Committee on Surface Mounting Technology

発行

社団法人 電子情報技術産業協会

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

目 次

1. 一般事項	1
1.1 適用範囲	1
1.2 引用規格	1
2. ランドパターン設計基準	2
2.1 ランドパターン寸法の分類	2
2.2 ランドパターン設計方法	2
2.3 製造コートヤード設計方法	4
3. 部品共通項目	5
4. QFJ(正方形)	5
5. QFJ(長方形)	9
解 説	12

電子情報技術産業協会規格

表面実装用部品のランドパターン設計指針：
個別規格 品種別要求事項
(4方向Jリード)

Land pattern design guideline for surface mount devices (SMDs):
Sectional requirements
(Chip carriers with J-Leads on four sides)

まえがき この規格は、表面実装部品(以下、SMDという。)のランドパターンに対する要求に基づき、品種別のランドパターン寸法について、社団法人 電子情報技術産業協会(以下、JEITAという。)標準・技術部 標準化センター 実装技術標準化委員会が作成したものである。

1. 一般事項

1.1 適用範囲 この規格は、4方向Jリードタイプ(QFJ: Quad Flat J-lead)のSMDに関するランドパターンの設計について適用する。

この規格で規定しているランドパターンは、JEITA ET-7501に規定している基本公式及び許容差に基づいて算出したものである。また、ランドパターンの設計者は、要求するはんだ付けの信頼性、工程の能力などに応じて、各部品の表に規定した値と違った許容差などを使用してもよい。ランドパターン設計方法及び製造コートヤード設計方法は、共通項目(2.2及び2.3)に記載する。ただし、各部品ごとに、適切な記述が必要であるため、次の様式で、適用範囲、引用規格、部品概要、部品寸法及びその許容差、設計条件並びにランドパターン寸法値を示す。ここで、「X」が部品種別の区分項目を表す。

- X.1 適用範囲
- X.2 引用規格
- X.3 部品概要
- X.4 部品寸法及び許容差
- X.5 設計条件(ランドパターン・製造コートヤード)
- X.6 ランドパターン寸法値

「X」 4: QFJ(正方形) 5: QFJ(長方形)

備考 部品寸法に記載されている数値は、ランドパターン設計に使用することができるが、部品規格に規定の寸法値とは整合しない場合がある。このときは、部品規格に規定の寸法値を用いて、算出することを推奨する。

1.2 引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。引用規格は、その最新版(Amendment・追補を含む。)を適用する。